

CA-IS3105W 隔离电源

测试板说明

描述

此份文件描述了 CA-IS3105W 测试板的相关使用说明，其中有产品介绍、原理图、PCB 布线图、物料清单以及部分测试数据等。CA-IS3105W 评估板可以用来简单评估 CA-IS3105W 内置的隔离电源的参数性能等。

芯片简介

CA-IS3105W 是一款支持 $5kV_{RMS}$ 隔离耐压的 DC-DC 转换器芯片，集成片上变压器，能够高效率传输大于 650mW 功率到副边输出。该芯片采用特有控制架构，能够快速响应负载变化，并且精确调节输出电压。CA-IS3105W 的出现可替代传统分立器件组建的隔离电源方案。该方案物理尺寸更小，且能够实现完全隔离。

CA-IS3105W 集成软启动、短路保护、过温保护等多种保护功能以更好地增强系统的可靠性。CA-IS3105W 具有 EN 使能管脚，当 EN 为低电时，输出电压为零，此时电源仅有微安级待机输入电流。

可通过管脚 SEL 选择 4 种输出电压，分别为 5V、3.3V、5.4V、3.7V，支持输出端接 LDO，以方便用户不同的电压需求。CA-IS3105W 器件采用 16 脚宽体 SOIC 封装，绝缘耐压高达 $5kV_{RMS}$ 。

测试板 3D 仿真图

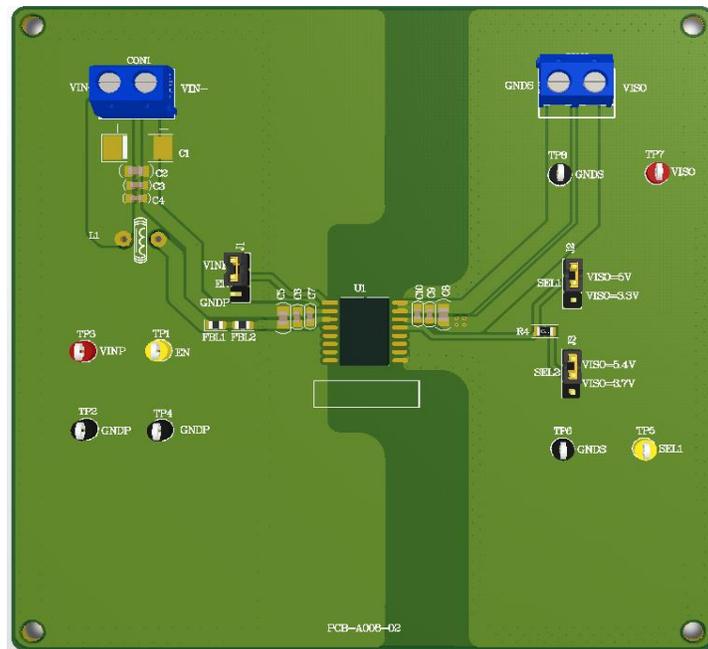


图 1 CA-IS3105W PCB 的 3D 仿真图

布线图

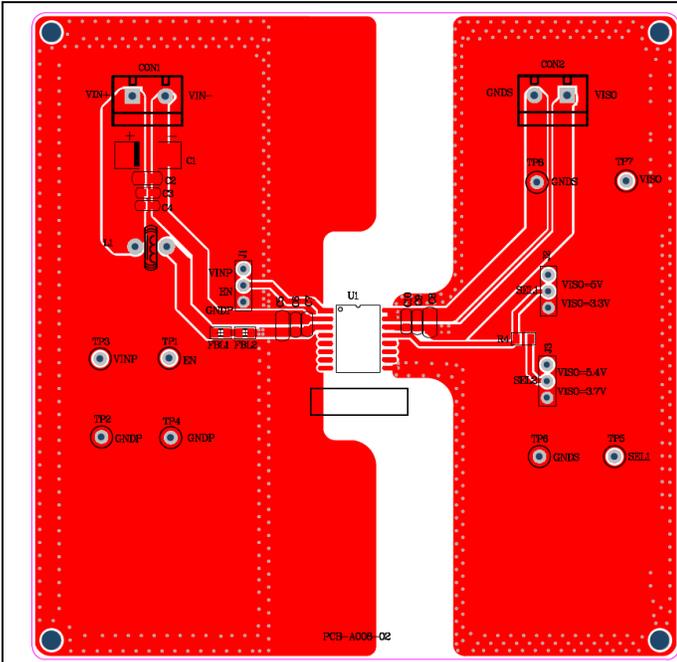


图 3 TOP

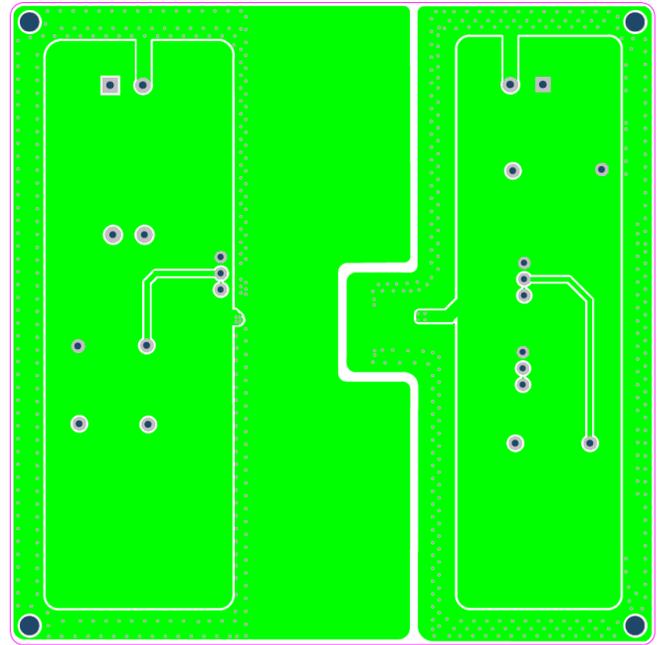


图 4 Inner Layer1

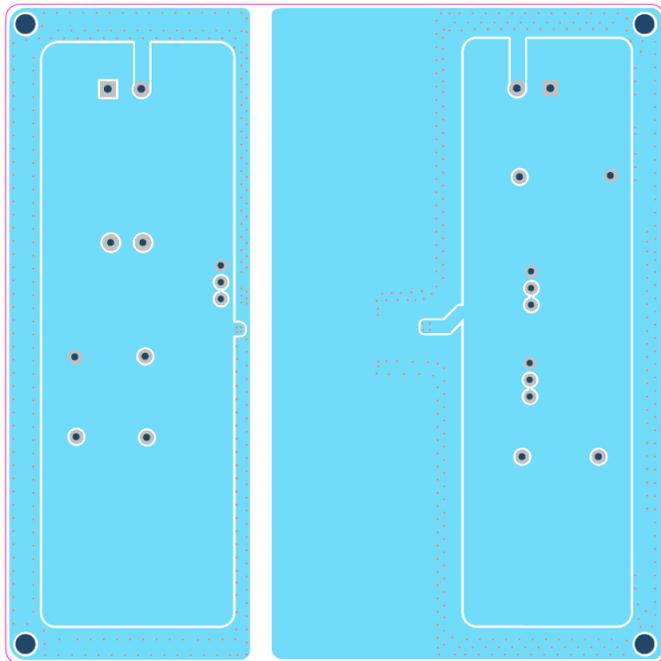


图 5 Inner Layer2

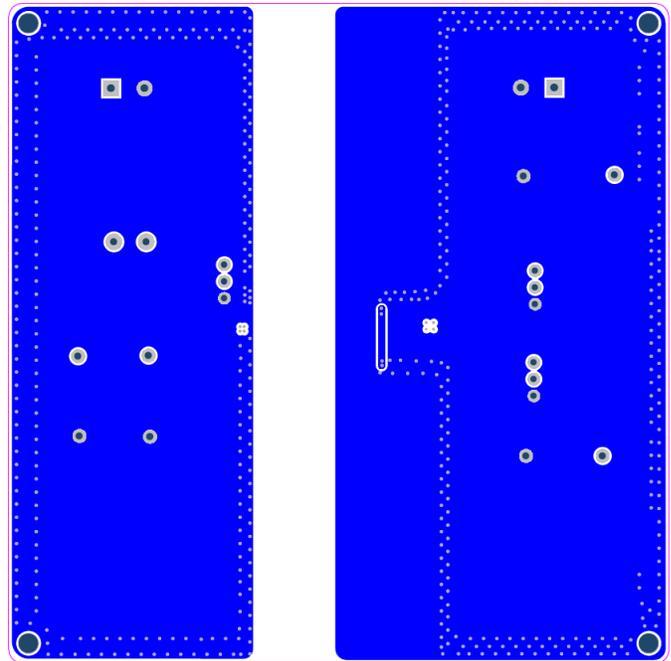


图 6 Bottom

物料清单

Item	Ref Des	Qty	Description	Package	MFR	PN.
1	CON1,CON2	2	CONN, 5.08mm, Rising Cage Clamp	-	Wurth Elektronik	691236510002
2	FBL1,FBL2	2	Beed 600Ω	0805	Linekey	FBG2912-601Y
3	C1	1	Tantalum cap,22uF	7343	AVX	TAJD226K025RNJ
4	C2,C5,C8	3	MLCC, 10μF/10V, X7R	0805	-	Standard
5	C3	1	MLCC, 1μF /10V, X7R	0603	-	Standard
6	C4, C6, C9	3	MLCC , 100nF/10V, X7R	0603	-	Standard
7	C7,C10	2	MLCC, 10nF/10V, X7R	0603	-	Standard
9	U1	1	CA-IS3105W	SOP16WB	Chipanalog	CA-IS3105W
10	L1	1	24uH, 0.7mm, 4.5mm*12mm	-	Wurth Elektronik	7447043
11	TP3,TP7	2	Test Point, Red, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5000
12	TP1,TP5	2	Test Point, Yellow, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5009
13	TP2,TP4,TP6,TP8	4	Test Point, Black, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5001
14	J1,J2,J3	3	Header, 3 pin, 2.54mm	-	-	Standard
15	PCB	1	Four layers PCB, FR-4, PCB-A008-02, 1.0mm thickness, 100mm*100mm, The distance between Inner Layer1 and Inner Layer2 should be greater than 0.4mm.	-	-	-

测试仪器

直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSOX3054T、6.5 位多功能万用表安捷伦 34465A、高频信号发生器等。

硬件连接

1. 将直流电压源连接到 CON1 和 CON2;
2. 将 EN 置高电平, 通过跳线帽将 SEL1/SEL2 分别置高或者置低电平, 选择不同的输出电压;
3. 通过示波器或者万用表测量输出电压。

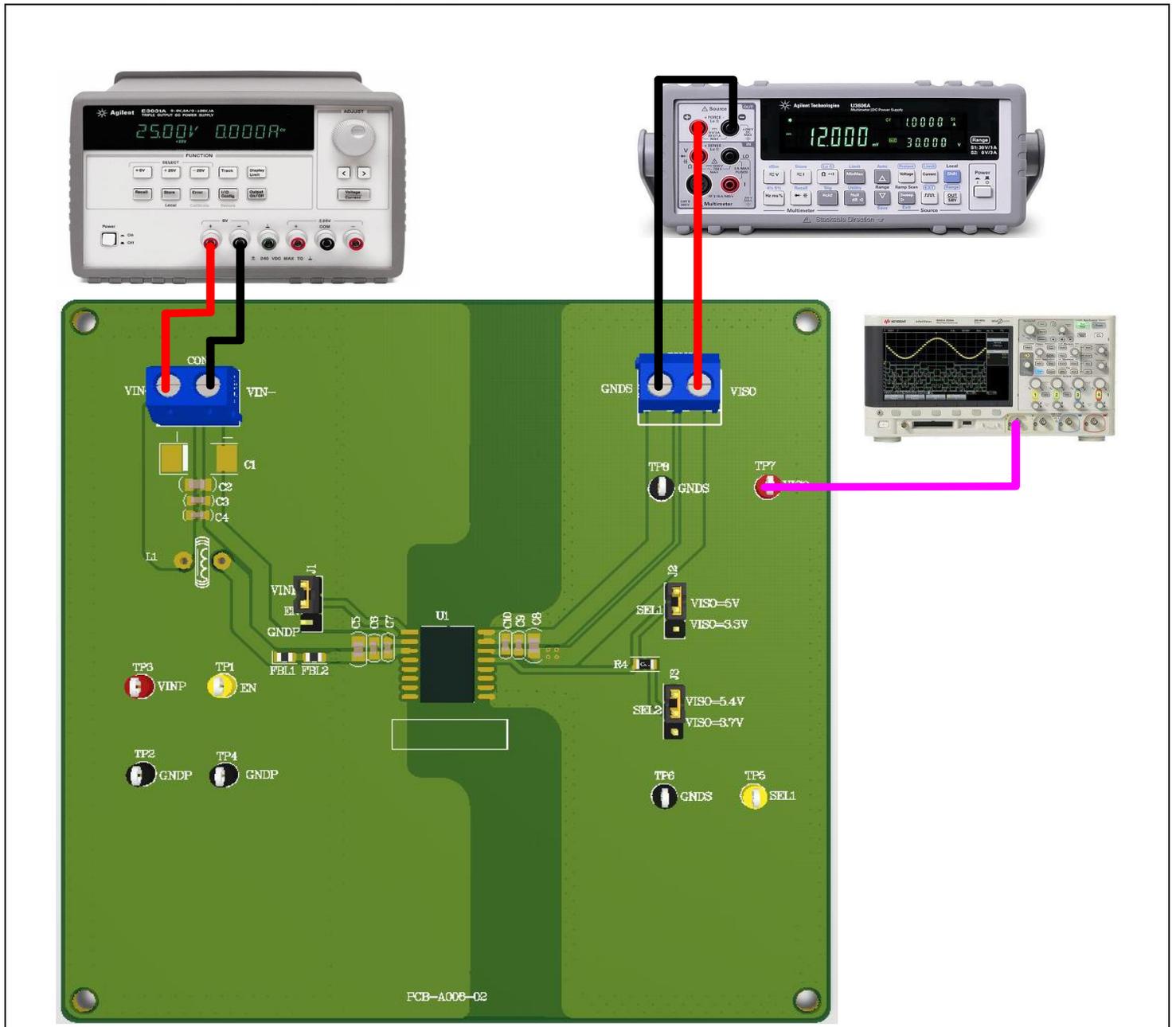


图 7 硬件连接图

测试示例

下面是以 CA-IS3105W 测试一些典型波形，包括启动波形、输出短路波形、输出纹波、输出动态响应、效率等。

<p>图 8 软启动波形 VINP=5V, VISO=5V, IISO=130mA</p>	<p>图 9 输出短路故障去除后自恢复 VINP=5V, VISO=5V, 输出短路恢复到 IISO=130mA</p>
<p>图 10 VISO 纹波电压峰峰值: 64mV VINP=5V, VISO=5V, IISO=130mA</p>	<p>图 11 VISO 纹波电压波峰的差值: 17mV VINP=5V, VISO=5V, 负载电流: 13mA/117mA</p>

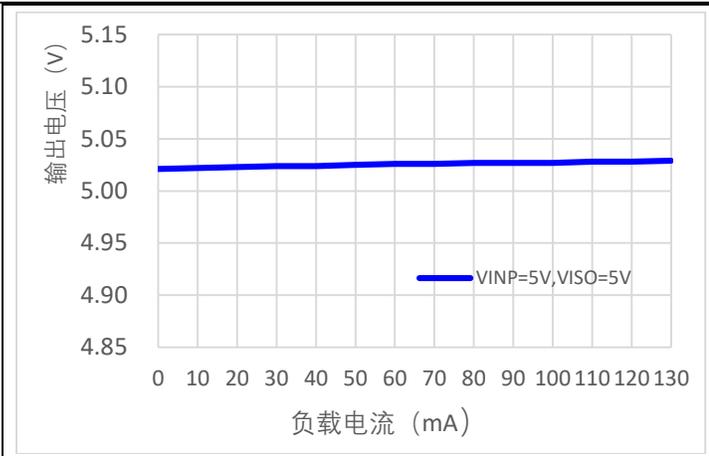


图 12 输出电压随负载电流的变化
VINP=5V, VISO=5V

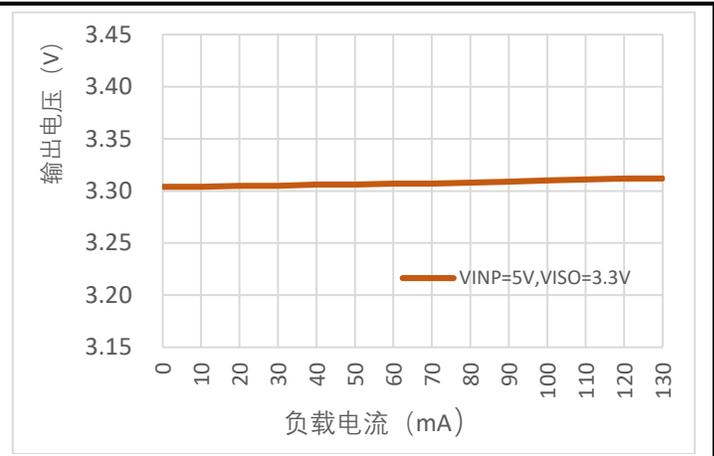


图 13 输出电压随负载电流的变化
VINP=5V, VISO=3.3V

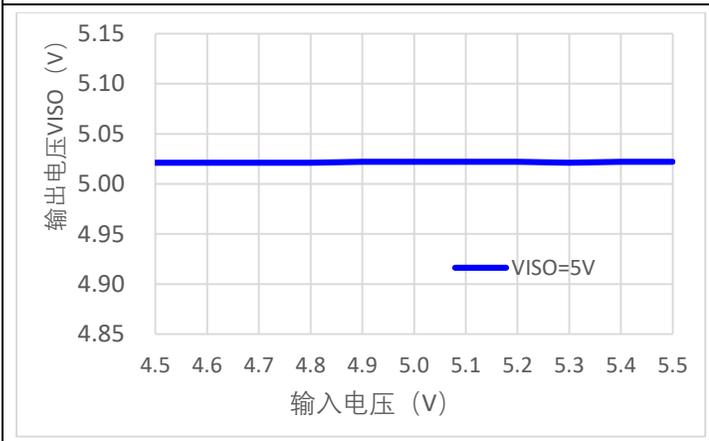


图 14 输出电压随负载电流的变化
VINP=5V, VISO=5V

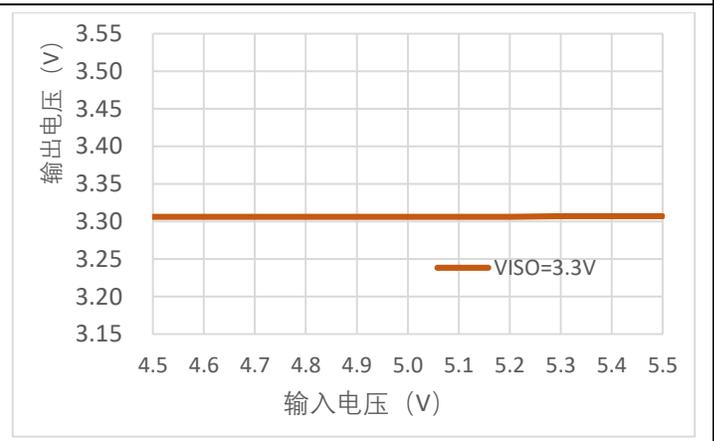


图 15 输出电压随负载电流的变化
VINP=5V, VISO=3.3V

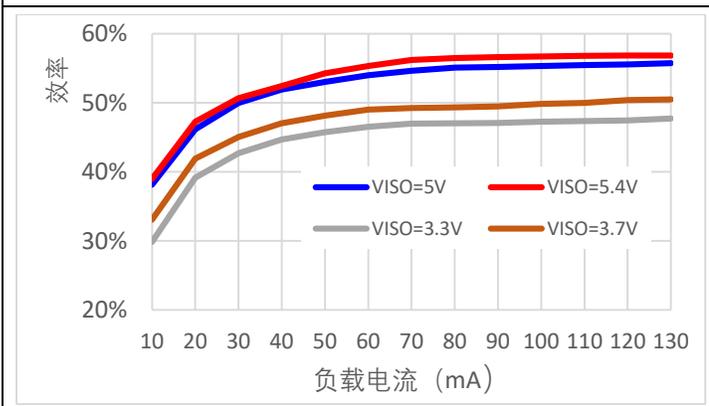


图 15 效率随负载电流的变化, 25°C
VINP=5V, VISO=5V; VINP=5V, VISO=5.4V;
VINP=5V, VISO=3.3V; VINP=5V, VISO=3.7V

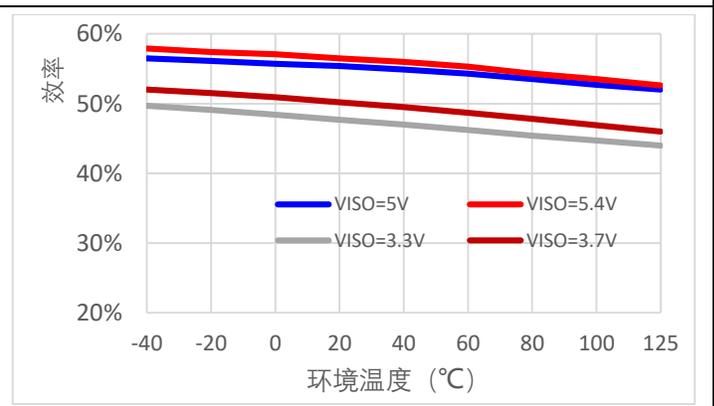


图 16 效率随芯片表面温度的变化, IISO=130mA
VINP=5V, VISO=5V; VINP=5V, VISO=5.4V;
VINP=5V, VISO=3.3V; VINP=5V, VISO=3.7V

PCB 布线建议

- CA-IS3105W 内置开关电源，为副边侧和外部模块提供稳压电源。输入侧VINP和输出侧VISO的旁路电容和供电电容的位置放尽可能摆放在靠近芯片的管脚，距离应控制在2mm以内，如下图17和图18所示。当需要在供电电源线和地线中放置过孔，应放置在电容相对于芯片管脚的外侧，而非放置在电容和芯片之间，以减少过孔寄生电感的影响，如下图19和图20所示。

图17 推荐	图18 不推荐	图19 推荐	图20 不推荐

- CA-IS3105W 集成隔离开关电源，存在一定的传导噪声和辐射噪声。适当的PCB拼接电容，对改善传导干扰和辐射干扰有一定的作用。如在PCB原边GNDP和副边GNDS之间的拼接电容以及VINP/VISO对GNDP/GNDS的拼接电容，如下图21，图22。此外，在PCB边缘处放置一系列间隔距离不大于3mm至4mm的地过孔，形成边缘防护，如下图23所示。

图21 原边GNDP和副边GNDS的拼接电容	图22 VINP/VISO对GNDP/GNDS的拼接电容	图23 VINP/VISO层四周用地平面包围，地平面外侧放置一系列间距小于4mm的过孔

Revision History

版本	日期	状态描述
Ver1.0	July.2021	初始版本

重要声明

上述资料仅供参考使用，用于协助 Chipanalog 客户进行设计与研发。Chipanalog 有权在不事先通知的情况下，保留因技术革新而改变上述资料的权利。

<http://www.chipanalog.com>